

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成25年8月1日(2013.8.1)

【公開番号】特開2011-3906(P2011-3906A)

【公開日】平成23年1月6日(2011.1.6)

【年通号数】公開・登録公報2011-001

【出願番号】特願2010-140053(P2010-140053)

【国際特許分類】

H 05 K 9/00 (2006.01)

H 05 K 1/02 (2006.01)

H 05 K 3/28 (2006.01)

【F I】

H 05 K 9/00 G

H 05 K 1/02 P

H 05 K 3/28 G

【手続補正書】

【提出日】平成25年6月18日(2013.6.18)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

回路部品(16)が搭載された電気システム(12)上に配置された誘電体被覆(18)であって、前記電気システム(12)の表面に共形になるように形状設定され、前記電気システムの前記表面上にあるコンタクトパッド(22)の上に配置された複数の開口(20)を有する誘電体被覆(18)と、

導電性被覆(24)であって、前記誘電体被覆(18)上に層状に重ねられ、かつ前記導電性被覆(24)と前記コンタクトパッド(22)の間に電気接続が形成されるように前記コンタクトパッド(22)上に層状に重ねられた導電性被覆(24)とを備え、

前記誘電体被覆(18)および前記導電性被覆(24)が、所望の回路部品(16)または回路部品(16)群を覆う前記形状適応構造のそれぞれの遮蔽領域(26)を分離するように貫通して形成された複数の重なり合う経路開口(27)を有する形状適応構造(10)。

【請求項2】

前記回路部品のそれぞれを覆う前記それぞれの遮蔽領域(26)が、前記回路部品を覆う前記誘電体被覆(18)および前記導電性被覆(24)からなる分離型パッチを備える、請求項1記載の形状適応構造(10)。

【請求項3】

前記複数の重なり合う経路開口(27)のそれぞれが、そのそれぞれに対応する遮蔽領域(26)を取り囲む閉ループ経路を備える、請求項1または2に記載の形状適応構造(10)。

【請求項4】

前記導電性被覆(24)が、微粒子金属スプレー被覆、スパッタリングした金属被覆、およびめっきした金属被覆のうち1つを備える、請求項1乃至3のいずれかに記載の形状適応構造(10)。

【請求項 5】

前記複数の重なり合う経路開口（27）のそれぞれが、約25～500マイクロメートルの幅を有する、請求項1乃至4のいずれかに記載の形状適応構造（10）。

【請求項 6】

前記複数の重なり合う経路開口（27）がレーザ切断経路開口を備える、請求項1乃至5のいずれかに記載の形状適応構造（10）。

【請求項 7】

前記誘電体被覆（18）と前記電気システム（12）の前記表面との間に配置されたはんだ層（17）をさらに備え、前記はんだ層（17）が、貫通して形成された、前記誘電体被覆および導電性被覆（18、24）内の前記複数の重なり合う経路開口（27）に重なり合う複数の経路開口（27）を含む、請求項1乃至6のいずれかに記載の形状適応構造（10）。

【請求項 8】

前記電気システム（12）が、プリント回路基板（P C B）、フレックスP C B、リジッドフレックスP C B、およびモジュールのうち1つを備える、請求項1乃至7のいずれかに記載の形状適応構造（10）。

【請求項 9】

前記電気システム（12）から前記分離型遮蔽領域（26）のそれぞれまで延び、それにより前記分離型遮蔽領域（26）を前記電気システム（12）に電気的に接地するパッケージフィードスルー（25）をさらに備える、請求項1乃至8のいずれかに記載の形状適応構造（10）。

【請求項 10】

前記導電性被覆（24）が、

第1の金属被覆であって、前記誘電体被覆（18）上に層状に重ねられ、かつ前記第1の金属被覆と前記コンタクトパッド（22）の間に電気接続が形成されるように前記複数の開口（20）内に層状に重ねられた第1の金属被覆と、

前記第1の金属被覆上に層状に重ねられた第2の金属被覆と

を備える、請求項1乃至9のいずれかに記載の形状適応構造（10）。